シリコン結晶薄膜太陽電池の高効率化技術

Efficiency Improvement in Microcrystalline Silicon Thin-film Solar Cells

西村和仁*	奈須野善之*	山本浩史*	早川尚志*
Kazuhito Nishimura	Yoshiyuki Nasuno	Hiroshi Yamamoto	Takashi Hayakawa

要 旨

現在,世界の太陽電池市場で主流である結晶シリコン太陽電池に対して,次世代の低コスト太陽電池の一つとして,薄膜シリコン太陽電池の研究開発が盛んに行われている。特に,アモルファスシリコン薄膜太陽電池と同様のプラズマCVD法で作製できるシリコン結晶薄膜太陽電池は,長波長域の光吸収係数がアモルファスシリコン薄膜太陽電池より高いという特徴を有することから,アモルファスシリコン/シリコン結晶薄膜のタンデム型太陽電池の下部セルとして利用することで,総合的に高い変換効率を得ることができる。本稿では,上記シリコン結晶薄膜太陽電池においてp型層の窒素合金化技術を用いて変換効率の向上を達成したので,その結果を報告する。

Silicon thin-film solar cells have been extensively studied and developed as one of promising low-cost solar cells for the next generation, though the current world photovoltaic market is dominated by crystalline silicon solar cells. Microcrystalline silicon (μ c-Si) thin-film solar cells can be fabricated using the same process of plasmaenhanced chemical vapor deposition (PECVD) as amorphous silicon (a-Si) thin-film solar cells. Since μ c-Si has higher optical absorption coefficients at long wavelengths than a-Si, it can be used as a bottom cell of an a-Si/ μ c-Si tandem solar cell to achieve high conversion efficiency. This paper describes the imporvement in conversion efficiency of a μ c-Si solar cell using a nitrogen added μ c-Si p-layer.

まえがき

薄膜シリコン太陽電池は、バルク型の結晶シリコン 太陽電池に対して半導体層の厚さが1/10 ~ 1/100であ るため、現在バルク型において問題となっているシリ コン原料不足の問題を回避するとともに、大幅な低コ スト化が期待できる次世代太陽電池として注目されて いる。現在、薄膜系太陽電池の中で最も生産量が多い アモルファスシリコン (a-Si) 太陽電池は、光吸収係数 が高く、数100nmの膜厚で作製できるが、光照射下で変 換効率が10%程度劣化するという特徴を有する。そ れに対して、上記a-Si太陽電池と同様の製法で作製で きるシリコン結晶薄膜太陽電池(以下、微結晶シリコン (μ c-Si) 太陽電池と記す)は、a-Si太陽電池と比較し、 より長波長域において光を吸収し、光劣化を生じない という特徴を有する。上記の2種類の太陽電池を積層 することで、より高い変換効率の薄膜太陽電池を得る ことができる。したがって、図1に示すような、a-Siセ ルを上部セル、µc-Siセルを下部セルとして積層した タンデムセルが、高効率薄膜太陽電池構造として期待 されている。上記タンデムセル構造においては、上部 セルが入射光の短波長域を、下部セルが入射光の長波 長域を効率よく吸収するため、太陽光のスペクトルを より広い波長域に亘って有効に利用することができる のである。

本稿では、上記a-Si/ µ c-Si タンデムセルにおける下 部セルの高効率化のために µ c-Si シングルセルの開放 電圧向上技術を開発したので、その結果を報告する。



図1 a-Si/ µ c-Si タンデム太陽電池構造図

Fig. 1 Schematic view of a-Si/µc-Si solar cell structure.

低温形成微結晶シリコン太陽電池における開 放電圧向上技術

 μ c-Si太陽電池は、a-Si太陽電池と同様のプラズ マCVD法を用いて作製することができる。プラズマ CVD法における作製プロセス温度としては、100℃以 下の低温においても結晶相の形成は可能であるが、通 常100℃~500℃程度の温度範囲が使用される場合が 多い。また、上記のようにして作製されるシリコン薄 膜は、結晶相とアモルファス相の混合相になる場合が 多く、このようなものを総称して微結晶シリコンと呼 んでいる。

本検討に用いたp-i-n接合を有するスーパーストレー ト型 µ c-Si 太陽電池における高効率化の方法として, 短絡電流密度の向上,および開放電圧の向上の2つが 主に挙げられる。前者の短絡電流密度向上の方法とし ては,光吸収層の高品質化による光吸収係数の向上や, 透明電極に形成したテクスチャー構造を用いてセルに 入射した光を有効利用する光閉じ込め技術¹⁾等が挙げ られる。後者の開放電圧向上の方法としては,結晶シ リコン相の大粒径化により多結晶シリコンの特性に漸 近させる方法,広バンドギャップ化などバンドエンジ ニアリングを用いる方法等が挙げられる。

上記の結晶シリコン相の大粒径化による開放電圧 の向上には,以下のような課題がある。一般的に,微結 晶または多結晶シリコン太陽電池の開放電圧は結晶粒 径の減少とともに低下することが知られており²⁾.プ ラズマCVD法を用いた µ c-Si 薄膜の製膜プロセスに おいて、微結晶の大粒径化を行いやすい高温プロセス の方が、高い開放電圧を得るためには有利であると考 えられる。しかしながら、プロセス温度が高温になる ほど酸素不純物のセル特性に与える影響は大きくなる ため、200℃を超える高温プロセスを用いてµc-Si太 陽電池の高効率化を行う場合は、より酸素不純物濃度 を低減するように不純物混入が少ない高真空装置を 使用する必要があった。一方,酸素不純物が比較的混 入しやすい真空装置を用いる場合は、プロセス温度を 200℃以下に下げることにより, i層中における酸素不 純物のドナー化が抑制され、高い変換効率が得られる ことが報告されている³⁾。量産用の安価な真空装置は 酸素不純物の混入の可能性が高いため、高効率な u c-Si太陽電池の量産のためには、200℃以下の低温プロ セスを用いた開放電圧向上技術が必要不可欠である ということができる。

微結晶の大粒径化を伴わずに開放電圧を向上させ るための技術として、広バンドギャップ層を含むヘテ ロ接合を利用するバンドエンジニアリング技術があ る。a-Si太陽電池や µ c-Si太陽電池では、上述したよう にp-i-n構造が用いられているが、全ての層に同一バン ドギャップの材料を用いるホモ接合に対して、各層の バンドプロファイルを変更したヘテロ接合とすること により開放電圧の向上が可能である。例えば, a-Siよ りも広バンドギャップであるa-SiCを光入射側である p層として用いることで、アモルファスシリコン太陽電 池において変換効率の向上が報告されている⁴⁾。上記 のように、光活性層であるi層よりも広バンドギャップ のp層を適用する場合、p層のフェルミ準位が価電子 帯準位近傍に充分シフトしていれば、p/i界面の導電 帯側においてi層からp層方向に電子の拡散障壁が形 成される。この障壁により, i層にて光生成された電 子がp層側に拡散して、多数キャリアである正孔と再 結合消滅する割合が低減されるため,開放電圧が向上 すると考えられる。

本稿では、上記のような開放電圧向上効果を狙い, 様々な作製条件で窒素合金化微結晶シリコンp層 (p- µ c-Si:N)を作製し, セル特性に与える影響を調べた ので、以下詳細に説明する。

2. 微結晶シリコンセルの作製および評価方法

本検討におけるµ c-Si太陽電池は,透明導電膜を有 するガラス基板上に,µ c-Si層をp層,i層,n層裏面電 極の順に堆積して作製した。µ c-Si層は,13.56MHz の励起周波数のプラズマCVDを用いて,200℃以下の 基板温度て形成した。i層の作製には、H₂で希釈されたSiH₄を原料ガスとして使用し、堆積速度は約3Å/sとした。これらの原料ガス以外に、p層およびn層の作製時にはドーピングガスとして、それぞれ、H₂で希釈されたB₂H₆、およびPH₃を使用した。p- μ c-Si:Nの作製には、窒素源としてN₂を使用した。p層中の窒素濃度は、二次イオン質量分析(SIMS)により測定した。また、p- μ c-Si:N層の結晶体積分率は、ラマン分光測定スペクトルから求めた、アモルファスシリコン相のピーク強度に対する結晶シリコン相のピーク強度の比(Ic/Ia)を用いて評価した。 μ c-Siセルの光照射時の特性は、AM1.5、照度100W/cm²、温度25℃、セル面積1 cm²の条件で測定した。

3. 窒素合金化 p層およびセル特性

p層単膜のSIMS測定から得られた,p層堆積時の N₂/SiH₄流量比と,膜中に含有される窒素濃度の関係を 図2に示す。p層製膜時の圧力は3.5Torrで一定とし, N₂/SiH₄流量比のみを変化させた結果,p層膜中の窒素 濃度は,ほぼN₂/SiH₄流量比に比例することが明らかと なった。したがって,N₂/SiH₄流量比の制御により,任 意の窒素濃度の μ c-Si:N 膜を得ることができる。

上記のような、窒素が含有された μ c-Si層において、 窒素濃度の増加とともに光学バンドギャップが増加す ることが知られている⁵⁾。したがって、上述したバンド エンジニアリングの観点から、p- μ c-Si:Nは μ c-Si太 陽電池の開放電圧向上のために有効であると考えられ る。

しかしながら, p層の窒素濃度を増加させたときに, 以下のような問題点が生じることが, 実験的に明らか となった。第一に,窒素濃度の増加とともにp層の導電



Fig. 2 N_2/SiH_4 gas ratio dependence of nitrogen concentration in p-layers.

率が低下するため、セルの直列抵抗成分が増加する。 これは、p型ドーパントであるホウ素の活性化率が低 下するためもたらされると考えられる。上記活性化率 の低下により、p層のフェルミ準位が価電子帯準位か ら離れるため、セルのp-n間内蔵電位が低下して開放 電圧が低下するおそれがある。第二に、窒素濃度の増 加とともに結晶相の成長よりアモルファス相の成長の 方が促進されるため、p層の結晶体積分率が低下する。 具体的には、窒素濃度がゼロのときのp層の結晶体積 分率Ic/Iaが6であるのに対し、窒素濃度が0.53atomic% のときは2以下に低下した。したがって、その後に堆 積するi層の結晶体積分率が下地層であるp層の影響 を受けて低下する。このようにi層の結晶体積分率が 低下することは、長波長域の光吸収特性の低下をもた らすため好ましくない。

上記の第一の問題点を解決するために,窒素濃度の 増加に応じて B_2H_d/SiH_4 流量比を増加させた。具体的 には,窒素濃度がゼロのときの B_2H_d/SiH_4 流量比に対し, 窒素濃度0.53atomic%のときの B_2H_d/SiH_4 流量比を2.2 倍とした。図3に、 B_2H_d/SiH_4 流量比を一定としたとき のp層導電率の窒素濃度依存性(a)と,窒素濃度の増加 とともに B_2H_d/SiH_4 流量比を増加させたときのp層導電 率の窒素濃度依存性(b)を示す。これによれば、(a)の 場合,0.2atomic%より高い窒素濃度領域では、窒素濃 度がゼロのときに対して1/10以下の導電率に低下して いたが、(b)の場合,最も高い窒素濃度においても、窒 素濃度領域における導電率を向上させることができ た。



図3 p 層導電率の窒素濃度依存性(a) B₂H₆/SiH₄ 流量比 一定,(b) N 濃度とともに B₂H₆/SiH₄ 流量比増加

Fig. 3 Nitrogen concentration dependence of conductivity of p-layers; (a) constant B_2H_6/SiH_4 gas ratio, (b) increasing B_2H_6/SiH_4 gas ratio with increasing nitrogen concentration.

さらに、上記第二の問題点を解決するために、 p層中の窒素濃度の増加に応じて H_2 /SiH₄流量比を増加させた。これにより、窒素濃度の増加に伴う結晶体積分率の低下分を補償することができた。結果として、**図3**の窒素濃度範囲全体に亘って、結晶体積分率 Ic/Iaを4~6の範囲とすることができた。

図3(b)の各窒素濃度のp層を,i層膜厚が1µmの µc-Siセルに適用した。p層の窒素濃度の増加ととも にセルの開放電圧は向上し,窒素濃度0.53atomic%にお いて560mVの最大値を示した。窒素を添加しないp層 を有するµc-Siセルの開放電圧値は520mVであるた め,40mVの開放電圧向上効果が得られている。さらに, 上記の窒素濃度が0.53atomic%であるp層を用いて,変



図4 窒素合金化 p 層適用セルの I-V 特性

Fig. 4 I-V characteristic of the cell with p-µc-Si:N.

換効率が最大となるようにi層膜厚の最適化を行った。 その際、ガラス上にZnO透明導電膜をスパッタリング したのち、ウェットエッチングによりテクスチャー構造 を形成した基板を使用した。光照射時のセルの電流-電圧特性を図4に示す。開放電圧540mV,短絡電流密 度26.5mA/cm²,形状因子0.70,変換効率10.0%を達成し た。

むすび

窒素合金化p層の適用により、200℃未満のプロセス温度を用いて作製した低温形成微結晶シリコン太陽 電池における開放電圧および変換効率の向上を実証 し、1cm²セルにおいて10.0%を達成した。

参考文献

- Y. Nasuno, M. Kondo, and A. Matsuda, "Effects of substrate surface morphology on microcrystalline silicon solar cells", Jpn. J. Appl. Phys. 40, pp.L303-305 (2001).
- R. B. Bergmann, "Crystalline Si thin-film solar cells: a review", Appl. Phys. A 69, pp.187-194 (1999).
- Y. Nasuno, M. Kondo, and A. Matsuda, "Passivation of oxygenrelated donors in microcrystalline silicon by low temperature deposition", Appl. Phys. Lett. 78, 16, pp.2330-2332 (2001).
- Y. Tawada, K. Tsuge, M. Kondo, H. Okamoto, and Y. Hamakawa, "Properties and structure of a-SiC:H for high-efficiency a-Si solar cell", J. Appl. Phys. 53, pp.5273-5281 (1982).
- T. Ehara, "The crystalline properties of nitrogen doped hydrogenated microcrystalline silicon thin films", Thin Solid Films 310, pp.322-326 (1997).

(2005年9月27日受領)